

表3

TABLE 3

加工方法 (METHOD)	パンチ加工 (PUNCHED HOLE)	ドリル加工 (DRILLED HOLE)
穴径 (HOLE DIA)	E	E
	0.8 <sup>+0.1</sup> <sub>0</sub>	0.9 <sup>+0.05</sup>

注:

- 1. 適用製品規格: 108-5221
- 2. キング加工位置は表2参照。
- 3. 適用基板厚 1.6
- △ パンチ加工の場合基板のフック発生に対し、充分配慮して加工してください。
- △ 回路 No.8 コンタクト無し品。
- △ Ni 下地無し。
- △ Ni 下地有。

NOTES:

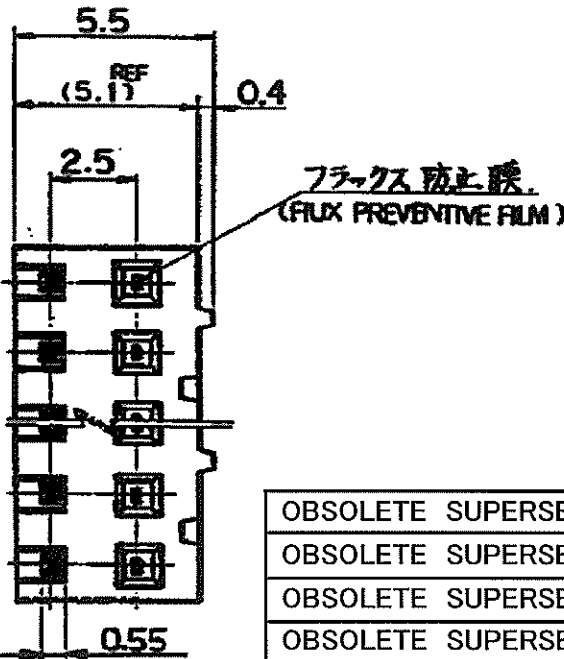
- 1. PRODUCT SPEC: 108-5221
- 2. KINKING POSITION (SEE TABLE 2)
- 3. APPLICABLE P.C.B THICKNESS 1.6
- △ MUST CONSIDER TO PREVENT CRACK OF P.C.B AT PROCESSING THE METHOD OF PUNCHED HOLE
- △ WITHOUT CONT CIRCUIT No.8.
- △ WITHOUT Ni UNDER PLATING.
- △ WITH Ni UNDER PLATING.

表1 (TABLE 1)

名称 (NAME)	材質表面処理 (MATERIAL & FINISH)
① リセ・ハウジング (RECE HOUSING)	6/6 ナイロン (94N-0) (6/6 NYLON)
② リセ・コンタクト (RECE CONTACT)	磷青銅 (鍍め仕上げ) (PHOS-BRONZE POST-TINNE)

表2 (TABLE 2)

回路 No. (CIRCUIT No.)	キング位置及び加工形状 (KINKING POSITION)								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	(A)	-	(B)	-	(A)	-	-	-	-
6.	(A)	-	(B)	-	(A)	-	-	-	-
9.	-	-	(A)	-	(B)	-	(A)	-	-



OBSOLETE SUPERSEDED BY 5-174074-8  
 OBSOLETE SUPERSEDED BY 5-174074-9  
 OBSOLETE SUPERSEDED BY 5-174074-6  
 OBSOLETE SUPERSEDED BY 5-174074-5

黒 (BLACK)	18	(16)	8	△5-174074-8 △
	18	16	9	△5-174074-9
	12	10	6	△5-174074-6
	10	8	5	△5-174074-5
	18	(16)	8	△9-174074-8 △
	18	16	9	△174074-9
色 (COLOR)	12	10	6	△174074-6
	10	8	5	△174074-5
	L	N	極数 (Pos)	型番 (P/N)

E	変更 ECR-07-013111	J.S	06JUN '07
D	変更 FJD0-0155-04	N.Y	23APR '04
C1	英文通記 (J86-9300)	ms	9/28
C	変更 (J-10413)	ms	10/10
B	極数追加 (J86-9300)	Y.A	ms 8/28
A	変更 (J86-9226)	J.A	ms 8/28
O	作成 (J86-9195)	J.A	ms 1/28
LTR	REV REVISION RECORD	DR	CHK DATE

Tyco Electronics		Tyco Electronics AMP K.K. Kawasaki, Japan	
REFERENCE RANGE	INSULATION DIA	SERIAL NAME アンアボトムエトリ-B-B コネクタ(20mmピッチ) リセ アッセムブリ	
REF MATERIAL 表1参照 SEE TABLE 1	REF FINISH 表1参照 SEE TABLE 1	BOTTOM ENTRY R-B CONN (20mm PITCH) RECE ASSY.	
DR: M. Saito 1/28	DE: M. Saito 1/28	SIZE: REF ±0.2 MKT ±0.25 MKT ±0.3 R E ±.5	LOC: A3 J
CHK: M. Saito 1/28	APP: M. Saito 1/28	REV: E	SHEET: 1/1

PRINTED IN JAPAN BY SHIMIZU DENKI CO. LTD. (P. 1)